PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-372784

(43) Date of publication of application: 26.12.2002

(51)Int.CI.

G03F 7/039 C08F220/18 H01L 21/027

(21)Application number : 2002-101333

(71) Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

03.04.2002

(72)Inventor: SATO KENICHIRO

UENISHI KAZUYA

(30)Priority

Priority number : 2001107304

Priority date: 05.04.2001

Priority country: JP

(54) POSITIVE TYPE RESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a positive type resist composition suitable for use in microphotofabrication using far ultraviolet light, particularly ArF excimer laser light, having high sensitivity and small density dependence and ensuring slight surface roughening in etching. SOLUTION: The positive type resist composition contains (A) a resin containing specified two repeating units and having a velocity of dissolution in an alkali developing solution increased by the action of an acid having an alicyclic hydrocarbon group in a side chain and (B) a specified compound which generates the acid when irradiated with active light or radiation.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK MENT

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特期2002-372784 (P2002-372784A)

(43)公開日 平成14年12月26日(2002.12.26)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

G03F 7/039

C08F 220/18

H01L 21/027

601

 \mathbf{F} I

G03F 7/039

テーマコート*(参考)

2H025

4J100

601

C 0 8 F 220/18

H 0 1 L 21/30

502R

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 48 頁)

(21)出願番号

特願2002-101333(P2002-101333)

(22)出顧日

平成14年4月3日(2002.4.3)

(31)優先権主張番号 特願2001-107304(P2001-107304)

(32)優先日

平成13年4月5日(2001.4.5)

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出題人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 佐藤 健一郎

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(72) 発明者 上西 一也

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(74)代理人 100105647

弁理士 小栗 昌平 (外4名)

最終頁に続く

ポジ型レジスト組成物 (54) 【発明の名称】

(57)【要約】

【課題】遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使 用したミクロフォトファブリケーションに於いて好適に 使用するととができる、髙感度であり、疎密依存性が小 さく、エッチング時の表面荒れが少ないポジ型レジスト 組成物を提供すること。

【解決手段】(A)特定の2種の繰り返し単位を含有 し、脂肪族環状炭化水素基を側鎖に有する酸の作用によ りアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂、及 び(B)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する 特定の化合物を含有することを特徴とするポジ型レジス 卜組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 脂肪族環状炭化水素基を側鎖に有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂として、下記一般式(Ia)で表される繰り返し単位と一般式(Ib)で表される繰り返し単位を含有する樹脂、及び(B)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするボジ型レジスト組成物。

1

【化1】

$$-CH_{2}-C-$$

$$A \qquad (Ib)$$

$$O=C \qquad R_{12}$$

$$O-C-R_{13}$$

$$R_{14}$$

式(Ia)及び(Ib)中、 R_1 は独立に水素原子又はアルキル基を表し、Aは連結基を表す。式(Ia)中、 R_{11} は炭素数 $1\sim4$ のアルキル基を表し、Zは炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。式(Ib)中、 $R_{12}\sim R_{14}$ は、A々独立に炭化水素基を表し、但し、 $R_{12}\sim R_{14}$ のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。

【請求項2】 更に、(C)フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することを特徴とする請求項1に記載のボジ型レジスト組成物。

【請求項3】 更に、(D) 有機塩基性化合物を含有することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のポジ型レジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、超LSIや髙容量マイクロチップの製造等の超マイクロリソグラフィプロセスやその他のフォトファブリケーションプロセスに使用するポジ型レジスト組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、集積回路はその集積度を益々高めており、超LS Iなどの半導体基板の製造に於いてはハーフミクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加工が必要とされるようになってきた。その必要性を満たす 50

ためにフォトリソグラフィーに用いられる露光装置の使用波長は益々短波化し、今では、遠紫外線の中でも短波長のエキシマレーザー光(XeCl、KrF、ArFなど)を用いることが検討されるまでになってきている。この波長領域におけるリソグラフィーのパターン形成に用いられるものとして、化学増幅系レジストがある。

[0003]一般に化学増幅系レジストは、通称2成分系、2.5成分系、3成分系の3種類に大別することができる。2成分系は、光分解により酸を発生する化合物(以後、光酸発生剤という)とバインダー樹脂とを組み合わせている。該バインダー樹脂は、酸の作用により分解して、樹脂のアルカリ現像液中での溶解性を増加させる基(酸分解性基ともいう)を分子内に有する樹脂である。2.5成分系はこうした2成分系に更に酸分解性基を有する低分子化合物を含有する。3成分系は光酸発生剤とアルカリ可溶性樹脂と上記低分子化合物を含有するものである。

【0004】上記化学増幅系レジストは紫外線や遠紫外 線照射用のフォトレジストに適しているが、その中でさ 20 らに使用上の要求特性に対応する必要がある。ArF光 源用のフォトレジスト組成物としては、ドライエッチン グ耐性付与の目的で脂環式炭化水素部位が導入された樹 脂が提案されているが、脂環式炭化水素部位導入の弊害 として系が極めて疎水的になるがために、従来レジスト 現像液として幅広く用いられてきたテトラメチルアンモ ニウムヒドロキシド (以下TMAH) 水溶液での現像が 困難となったり、現像中に基板からレジストが剥がれて しまうなどの現象が見られる。このようなレジストの疎 水化に対応して、現像液にイソプロピルアルコールなど の有機溶媒を混ぜるなどの対応が検討され、一応の成果 が見られるものの、レジスト膜の膨潤の懸念やプロセス が煩雑になるなど必ずしも問題が解決されたとは言えな い。レジストの改良というアプローチでは親水基の導入 により疎水的な種々の脂環式炭化水素部位を補うという 施策も数多くなされている。

【0005】特開平9-73173号公報には、脂環式基を含む構造で保護されたアルカリ可溶性基と、そのアルカリ可溶性基が酸により離脱して、アルカリ可溶性とならしめる構造単位を含む酸感応性化合物を用いたレジスト材料が記載されている。また、特開平11-11943434号は、高解像性、高感度で、ドライエッチング耐性が向上した、低コストのレジスト材料として、脂環式炭化水素を有する繰り返し単位、ラクトン構造を有する繰り返し単位を含有する樹脂を使用したレジスト材料を提案している。

【0006】しかしながら、従来のポジ型レジスト組成物は、遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使用したミクロフォトファブリケーションに於いて、感度、疎密依存性、エッチング時の表面荒れの点で良好な成果が得られていなかった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使用したミクロフォトファブリケーションに於いて好適に使用することができる、高感度であり、疎密依存性が小さく、エッチング時の表面荒れが少ないポジ型レジスト組成物を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、ポジ型化 学増幅系レジスト組成物の構成材料を鋭意検討した結 果、特定の酸分解性樹脂を用いることにより、本発明の 目的が達成されることを見出し本発明に至った。即ち、 上記目的は下記構成によって達成される。

【0009】(1)(A)脂肪族環状炭化水素基を側鎖に有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂として、下記一般式(Ia)で表される繰り返し単位と一般式(Ib)で表される繰り返し単位を含有する樹脂、及び(B)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

[0010] [化2]

$$-CH_{2}-C-$$

$$O=C R_{11}$$

$$O-C$$

$$O-C$$

【0011】式(Ia)及び(Ib)中、 R_1 は独立に水素原子又はアルキル基を表し、Aは連結基を表す。式(Ia)中、 R_{11} は炭素数 $1\sim4$ のアルキル基を表し、乙は炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。式(Ib)中、 $R_{12}\sim R_{14}$ は、各々独立に炭化水素基を表し、但し、 $R_{12}\sim R_{14}$ のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。

【0012】(2) 更に、(C)フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することを特徴とする

- (1) に記載のポジ型レジスト組成物。
- (3) 更に、(D) 有機塩基性化合物を含有すること

を特徴とする(1)又は(2)に記載のポジ型レジスト 組成物。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明に使用する成分について詳細に説明する。

〔1〕(A)酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶 解速度が増加する樹脂(「酸分解性樹脂」ともいう)。 式(Ia)及び(Ib)中、R」は独立に水素原子又は アルキル基を表す。R₁のアルキル基としては、好まし 10 くは炭素数1~4個のアルキル基(メチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソ ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基)、特に好 ましくは水素原子、メチル基である。Aは、連結基を表 し、一般的には、単結合、アルキレン基、置換アルキレ ン基、エーテル基、チオエーテル基、カルポニル基、エ ステル基、アミド基、スルフォンアミド基、ウレタン 基、又はウレア基よりなる群から選択される単独あるい は2つ以上の基の組み合わせを表す。Aとしての連結基 は、好ましくは炭素数10以下である。Aのアルキレン 20 基としては、下記式で表される基を挙げることができ る。

$-(C(Rf)(Rg))r_{1}-$

上記式中、Rf、Rgは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エドキシ基、ブロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。r,は1~10の整数である。

【0014】式(Ia)中、R₁₁は炭素数1~4のアルキル基(メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ローブチル基、イソプチル基、secーブチル基、tーブチル基)を表し、Zは炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。

【0015】式(Ib)中、 $R_{12}\sim R_{14}$ は、各々独立に 炭化水素基を表し、但し、 $R_{12}\sim R_{14}$ のうち少なくとも 1つは脂環式炭化水素基を表す。

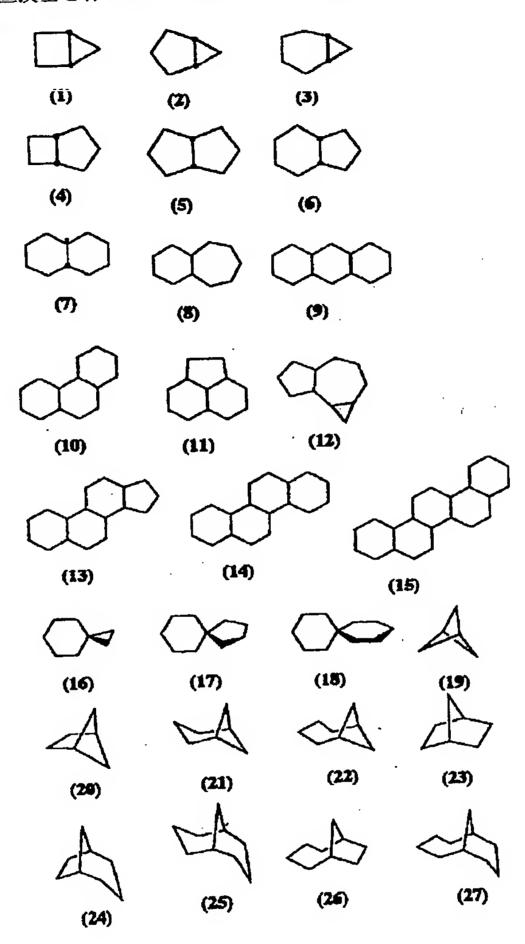
【0016】R₁₂~R₁₄の脂環式炭化水素基以外の炭化水素基としては、好ましくは炭素数1~15の直鎖又は分岐アルキル基(特に好ましくは炭素数1~4)である。

【0017】R12~R14における脂環式炭化水素基あるいは乙と炭素原子が形成する脂環式炭化水素基は、単環式でも、多環式でもよい。具体的には、炭素数5以上の

モノシクロ、ビシクロ、トリシクロ、テトラシクロ構造等を有する基を挙げることができる。その炭素数は6~30個が好ましく、特に炭素数7~25個が好ましい。 これらの脂環式炭化水素基は置換基を有していてもよ *

*い。以下に、脂環式炭化水素基のうち、脂環式部分の構造例を示す。 【0018】

[化3]



[0019] [化4]

(28)(31) (33) (32)(35) (34)(36) (35) (37) (39) (41)(40)(42)(43) (45)(44)(46)

[0020] 【化5】 (49)(48)(50)(47)

Ia-1 CH₃ ĊH3

*【0021】本発明においては、上記脂環式部分の好ま しいものとしては、アダマンチル基、ノルアダマンチル 基、デカリン残基、トリシクロデカニル基、テトラシク ロドデカニル基、ノルボルニル基、セドロール基、シク ロヘキシル基、シクロヘブチル基、シクロオクチル基、 シクロデカニル基、シクロドデカニル基を挙げることが できる。より好ましくは、アダマンチル基、デカリン残 基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロヘキシル 基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロデカ 10 ニル基、シクロドデカニル基である。

【0022】これらの脂環式炭化水素基の置換基として は、例えば、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原 子、水酸基、カルボニル基 (=0) が挙げられる。アル キル基としてはメチル基、エチル基、プロビル基、イソ プロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、 更に好ましくはメチル基、エチル基、プロビル基、イソ プロピル基よりなる群から選択された置換基を表す。置 換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原 子、アルコキシ基を挙げることができる。上記アルコキ 20 シ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、 ブトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げることがで きる。

【0023】以下、一般式(la)又は(lb)で表さ れる繰り返し単位に相当するモノマーの具体例を示す。 [0024] [化6]

$$\begin{array}{c} H \\ \longrightarrow \\ O \end{array} \begin{array}{c} CH(CH_3)_2 \\ \longrightarrow \\ O \end{array}$$

[0025]

[化7]

*

Ie-2

H

[0026]

Ia-13
$$CH_3 CH_3 CH_3$$

$$O CH_3 CH_3$$

$$O CH_3 CH_3$$

Ia-14
$$H \longrightarrow CH_3 CH_3$$

$$O \longrightarrow H_3 C CH_3$$

$$= \underbrace{\begin{array}{c} CH_3 \\ H_3C \\ 0 \end{array}}$$

In-18
$$CH_3 H_3 C$$

$$0$$

$$(169)$$

[0027]

[0028]

$$\begin{array}{c} *10* [{1 \times 10}] \\ *10* [{1 \times 10}] \\ *18-23 \\ *18-23 \\ *18-23 \\ *19-$$

%[0030]

【化12】

【0029】 【化11】 Ia-24

CH₃ O CH₃ 20

Ia-25

$$= \begin{array}{c} CH_3 \\ O \\ O \\ O \end{array}$$

 $\begin{array}{c}
\text{Tb-1} & CH_3 & CH_3 \\
CH_3 & CH_3
\end{array}$ $\begin{array}{c}
\text{CH}_3 & CH_3
\end{array}$

$$= \begin{matrix} H & CH_3 \\ \hline & O - CH_3 \end{matrix}$$

 $\begin{array}{c}
 \text{Ib-3} & \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\
 & \text{CH}_2 & \text{CH}_3
\end{array}$

$$\begin{array}{c}
\text{Ib-4} \\
\text{H} \\
\text{O} \\
\text{CH}_2)_3\text{CH}_3
\end{array}$$

[0031]

Ib-5 CH₃ CH₃ CH₃ CH₃ CH₃

$$= \begin{matrix} H & CH_3 \\ -C & CH_3 \end{matrix}$$

[0032]

【化14】

Ib-8

14

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_3 \\
 & CH_3 \\
 & CH_3
\end{array}$$

$$= \begin{array}{c} H \\ O - C - CH_3 \end{array}$$

【0033】本発明の(A)酸分解性樹脂は、更に下記一般式(pIII)~(pV)で示される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位を含有してもよい。

[0034] [化15]

$$R_{19}$$
 R_{20}
 R_{21}
 R_{18}
 R_{20}
 R_{21}

$$R_{22}$$
 R_{23} O II $-C$ $-CH$ $-C$ $-R_{24}$ (pV) R_{25}

【0035】(上記式中、R1,及びR1,は、各々独立に、炭素数1~4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、R1,及びR1,のいずれかは脂環式炭化水素基を表す。R1,~R1,は、各々独立に、水素原子、炭素数1~4個の、直鎖もしくは分40岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、R1,~R1,のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。また、R1, R1,のいずれかは炭素数1~4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表す。R1,~R1,は、各々独立に、炭素数1~4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、R1,~R1,のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表し、但し、R1,~R1,のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表し、化水素基を表し、化水素基を表し、のちりたなくとも1つは脂環式炭化水素基を表し、のちりたなくとも1つは脂環式炭化水素基を表し、のちりたなくとも1つは脂環式炭化水素基を表し、のちりたなくとも1つは脂環式炭化水素基を表し、のちりたなくとも1つは脂環式炭化水素基を表し、のちりたのちりたのよい。)

【0036】一般式 (pIII) ~ (pV) において、R

15~R25におけるアルキル基としては、置換もしくは非 置換のいずれであってもよい、1~4個の炭素原子を有 する直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。そのアルキ ル基としては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピ ル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、 sec-ブチル基、t-ブチル基等が挙げられる。ま た、上記アルキル基の更なる置換基としては、炭素数1 ~4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩 素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、アシル基、アシロキ シ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、アルコキシカ ルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

【0037】上記樹脂における一般式(pIII)~(pV)で示される構造は、アルカリ可溶性基の保護に使用することができる。アルカリ可溶性基としては、この技術分野において公知の種々の基が挙げられる。具体的には、カルボン酸基、スルホン酸基、フェノール基、チオール基などが挙げられ、好ましくはカルボン酸基、スルホン酸基である。上記樹脂における一般式(pIII)~(pV)で示される構造で保護されたアルカリ可溶性基としては、好ましくは下記一般式(pVIII)~(pXI)で表される基が挙げられる。

[0038]

【化16】

50

【0039】 CCで、R1、~R2、は、それぞれ前記定義に同じである。上記樹脂において、一般式(pIII)~(pV)で示される構造で保護されたアルカリ可溶性基 20を有する繰り返し単位としては、下記一般式(pA)で*

16 *示される繰り返し単位が好ましい。

[0040]

【化17]

$$\begin{array}{c}
 & R \\
 & R \\$$

10 【0041】 CCで、Rは、水素原子、ハロゲン原子又は1~4個の炭素原子を有する置換もしくは非置換の直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。複数のRは、各々同じでも異なっていてもよい。Aは、式(Ia)(Ib)におけるのと同様である。Raは、上記式(pIII)~(pV)のいずれかの基を表す。

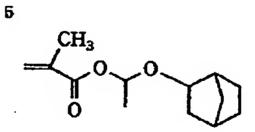
【0042】以下に一般式(pA)で表される繰り返し 単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものでは ない。

[0043]

[化18]

CH₃

[0044]



【0045】本発明の酸分解性樹脂は、更に下記一般式 (IV) で表されるラクトン構造を有する繰り返し単位を含有することができる。

[0046]

【化20】

【0047】一般式(IV)中、 R_1 aは、水素原子又はメチル基を表す。 W_1 は、単結合、アルキレン基、エーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。 Ra_1 , Rb_1 , Rc_1 , Rd_1 , Re_1 は各々独立に、水素原子又は炭素数 $1\sim4$ のアルキル基を表す。m, nは各々独立に $0\sim3$ の整数を表し、m+nは、2以上6以下である。

【0048】Ra₁~Re₁の炭素数1~4のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロビル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基等を挙げることができる。

【0049】一般式 (IV) において、W1のアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。

 $-(C(Rf)(Rg))r_1-$

上記式中、Rf、Rgは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロビル基、イソプロビル基、プチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロビル基、イソプロビ

ル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロボキシ基、ブトキシ基等の炭素数 $1\sim4$ のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。 r_1 は $1\sim1$ 0 の整数である。

[0050]上記アルキル基における更なる置換基とし ては、カルボキシル基、アシルオキシ基、シアノ基、ア ルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、ア ルコキシ基、置換アルコキシ基、アセチルアミド基、ア ルコキシカルボニル基、アシル基が挙げられる。ことで アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル 基、イソプロビル基、ブチル基、シクロプロビル基、シ クロブチル基、シクロベンチル基等の低級アルキル基を 挙げることができる。置換アルキル基の置換基として は、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げること ができる。置換アルコキシ基の置換基としては、アルコ キシ基等を挙げることができる。アルコキシ基として 20 は、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ 基等の炭素数1~4のものを挙げることができる。アシ ルオキシ基としては、アセトキシ基等が挙げられる。ハ ロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原 子、沃素原子等を挙げることができる。

【0051】以下、一般式 (IV) で示される繰り返し構造単位に相当するモノマーの具体例を示すが、これらに限定されるものではない。

[0052]

【化21】

[0053]

【化22】

特開2002-372784

[化23]

[0054]

【0055】上記一般式(IV)の具体例において、露光マージンがより良好になるという点から(IV-17)~(IV-36)が好ましい。更に一般式(IV)の構造としては、エッジラフネスが良好になるという点からアクリレート構造を有するものが好ましい。

【0056】また、下記一般式 (V-1) ~ (V-4) のいずれかで表される基を有する繰り返し単位を含有しても良い。

[0057]

【化24】

$$R_{1b}$$
 R_{2b}
 R_{3b}
 R_{4b}
 R_{2b}
 R_{5b}
 R_{2b}
 R_{3b}
 R_{4b}
 R_{5b}
 R_{2b}
 R_{4b}
 R_{4b}
 R_{2b}
 R_{5b}
 R_{4b}
 R_{2b}
 R_{5b}
 R_{4b}
 R_{5b}
 R_{4b}
 R_{4b}

【0058】一般式 (V-1) ~ (V-4) において、R₁,~R₅,は、各々独立に水素原子、置換基を有していてもよい、アルキル基、シクロアルキル基又はアルケニル基を表す。R₁,~R₅,の内の2つは、結合して環を形のしてもよい。

25 【0059】一般式 (V-1)~ (V-4) において、 R10~R50におけるアルキル基としては、直鎖状、分岐 状のアルキル基が挙げられ、置換基を有していてもよ い。直鎖状、分岐状のアルキル基としては、炭素数1~ 12個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基が好ましく、 より好ましくは炭素数1~10個の直鎖状あるいは分岐 状アルキル基であり、更に好ましくはメチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基、n - ブチル基、イソ ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、ペンチル 基、ヘキシル基、ヘブチル基、オクチル基、ノニル基、 デシル基である。R16~R56におけるシクロアルキル基 としては、シクロプロビル基、シクロペンチル基、シク ロヘキシル基、シクロヘブチル基、シクロオクチル基等 の炭素数3~8個のものが好ましい。R1,~R5,におけ るアルケニル基としては、ビニル基、プロペニル基、ブ テニル基、ヘキセニル基等の炭素数2~6個のものが好 ましい。また、R10~R50の内の2つが結合して形成す る環としては、シクロプロパン環、シクロブタン環、シ クロペンタン環、シクロヘキサン環、シクロオクタン環 等の3~8 員環が挙げられる。なお、一般式(V-1) ~ (V-4) におけるR16~R56は、環状骨格を構成し ている炭素原子のいずれに連結していてもよい。

【0060】また、上記アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基が有してもよい好ましい置換基としては、炭素数1~4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(ファ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、炭素数2~5のアシル基、炭素数2~5のアシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、炭素数2~5のアルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。【0061】一般式(V-1)~(V-4)で表される基を有する繰り返し単位としては、下記一般式(AI)で表される繰り返し単位等を挙げることができる。

[0062]

[化25]

【0063】一般式(AI)中、R。は、水素原子、ハロゲン原子、又は炭素数1~4の置換もしくは非置換のアルキル基を表す。R。のアルキル基が有していてもよい好ましい置換基としては、前記一般式(V-1)~(V-4)におけるR」。としてのアルキル基が有していてもよい好ましい置換基として先に例示したものが挙げられる。R。のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子を挙げることができる。R

。は水素原子が好ましい。A'は、単結合、エーテル基、エステル基、カルボニル基、アルキレン基、又はこれらを組み合わせた2価の基を表す。B,は、一般式(V-1)~(V-4)のうちのいずれかで示される基を表す。A'において、該組み合わせた2価の基としては、例えば下記式のものが挙げられる。

[0064]

[化26]

$$\begin{array}{c}
\begin{pmatrix}
R_{ab} \\
C \\
C
\end{pmatrix} & O \\
C \\
R_{bb} \\
C
\end{pmatrix} & C \\
C \\
R_{bb} \\
C
\end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c}
\begin{pmatrix}
R_{ab} \\
C \\
R_{bb}
\end{pmatrix}_{r1} = 0 - \begin{pmatrix}
R_{ab} \\
C \\
R_{bb}
\end{pmatrix}_{r1}$$

$$-\left(O-CH_2CH_2-C\right)_{m}O-\left(C\right)_{R_{bb}/rl}^{R_{eb}}$$

【0065】上記式において、Rab、Rbbは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、炭素数1~4のアルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、ファ素原子、沃素原子等を挙げることができる。「1は1~10の整数、好ましくは1~4の整数を表す。」は1~3の整数、好ましくは1又は2を表す。

[0066]以下に、一般式(AI)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

[0067]

[化27]

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
+CH_2-C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C \\
C \\
O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C \\
O \\
(AI- H_3C)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C \\
O \\
C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
-CH_2-C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
C-O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
H \\
CH_2-C \\
O \\
C-O \\
H_3C
\end{array}$$
(AI-6)

[0068]

[作28]

[0069]

[化29]

[0070]

[化30]

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ -(CH_{2}-C) \\ C-O \\ (CH_{2})_{2}-O \\ C-(CH_{2})_{2}-C \\ O \\ (A1-24) \end{array}$$

$$-(CH_{2}-C) - (CH_{2})_{2}-O - (CH_{2})_{2}-C - (CH_{2}$$

[0071]

30 【化31】

[0072]

[化32]

$$CH_3$$
 CH_2
 $CC-O$
 $CC-O$

$$-(CH_{2}-C)$$

$$-(CH_{2})_{2}-O$$

$$(CH_{2})_{2}-O$$

$$(AI-39)$$

$$-(CH_2-C-)$$
 $-(CH_2-C-)$
 $-(CH_2)_2-O$
 $-(CH_2)_2-C$
 $-(CH_2)_2-C$
 $-(CH_3)_2-C$
 $-($

[化33]

[0073]

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
-(CH_{2}-C) \\
C - O \\
C - (CH_{2})_{2} - O \\
C - (CH_{2})_{2} - C \\
O \\
H_{3}C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
CH_{3} \\
CH_{3} \\
CH_{3} \\
CH_{3} \\
CH_{4} - C \\
CH_{5}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
-(CH_{2}-C) \\
C-C \\
C-C \\
C-(CH_{2})_{2}-C \\
C-(CH_{2})_{2}-C \\
C-(CH_{3})_{2}-C \\
C-(CH_{3})_{2}-C \\
C-(CH_{2})_{2}-C \\
C-(CH_{3})_{2}-C \\
C-(CH_{3})_{3}-C \\
C-(CH_{3})_{2}-C \\
C-(CH_{3})_{3}-C \\
C-(CH_{3$$

$$-(CH_{2}-C)$$

$$C-O$$

$$(CH_{2})_{2}-O$$

$$C-(CH_{2})_{2}-C$$

$$O$$

$$H_{3}C$$

$$(AI-44)$$

【0074】また、本発明の酸分解性樹脂は、更に下記一般式(VI)で表される繰り返し単位を含有することができる。

[0075]

【化34】

【0076】一般式(VI)において、A。は単結合、アルキレン基、シクロアルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表

す。 $R_{\bullet \bullet}$ は水素原子、炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基、シアノ基、又はハロゲン原子を表す。

【0077】一般式 (VI) において、A。のアルキレン 基としては、下記式で表される基を挙げることができ 40 る。

-(C(Rnf)(Rng))r-

上記式中、Rnf、Rngは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げるととができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エト

キシ基、プロボキシ基、プトキシ基等の炭素数1~4のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。rは1~10の整数である。一般式(VI)において、A。のシクロアルキレン基としては、炭素数3から10個のものが挙げられ、シクロペンチレン基、シクロペキシレン基、シクロオクチレン基等を挙げることができる。

【0078】 Z。を含む有橋式脂環式環は、置換基を有していてもよい。置換基としては、例えば、ハロゲン原 10子、アルコキシ基(好ましくは炭素数 1~4)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数 1~5)、アシル基(例えば、ホルミル基、ベンゾイル基)、アシロキシ基(例えば、プロビルカルボニルオキシ基、ベンゾイルオキシ基)、アルキル基(好ましくは炭素数 1~4)、カ*

*ルボキシル基、水酸基、アルキルスルホニルスルファモイル基 (-CONHSO, CH,等)が挙げられる。尚、 置換基としてのアルキル基は、更に水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基 (好ましくは炭素数 1~4)等で置換されていてもよい。

[0079] 一般式 (VI) において、A。に結合しているエステル基の酸素原子は、Z。を含む有橋式脂環式環構造を構成する炭素原子のいずれの位置で結合してもよい。

10 【0080】以下に、一般式 (VI) で表される繰り返し 単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものでは ない。

[0081] [化35]

[化36]

[0082]

【0083】更に、下記一般式(VII)で表される基を有する繰り返し単位を含有してもよい。

[0084]

【化37】

$$R_{2c}$$
 R_{4c}
 R_{3c}
 R_{4c}
 R_{10}

【0085】一般式 (VII) 中、 $R_*c\sim R_*c$ は、各々独立に水素原子又は水酸基を表す。ただし、 $R_*c\sim R_*c$ の うち少なくとも 1 つは水酸基を表す。

【0086】一般式 (VII) で表される基は、好ましくはジヒドロキシ体、モノヒドロキシ体であり、より好ましくはジヒドロキシ体である。

【0087】一般式 (VII) で表される基を有する繰り返し単位としては、下記一般式 (AII) で表される繰り返し単位等を挙げることができる。

[0088]

【化38】

$$\begin{array}{c}
R_{1a} \\
C=0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{1a} \\
C=0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{2c} \\
R_{3c}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{4c}
\end{array}$$

【0089】一般式 (AII) 中、R, cは、水素原子又はメチル基を表す。R, c $\sim R$, cは、各々独立に水素原子又は水酸基を表す。ただし、R, c $\sim R$, cのうち少なくとも1つは水酸基を表す。

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{2}-CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{3}-CONHSO_{2}CH_{3}$$

$$-CH_{3}-CONHSO_{2}CH_{3}$$

20 【0090】以下に、一般式(AII)で表される構造を 有する繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定 されるものではない。

> [0091] [化39]

40

$$-CH_{2}-CH- OH OH$$

$$-CH_{2}-C$$

$$CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{2}$$

$$C - O - OH$$

$$C - OH$$

$$C + OH$$

$$C + OH$$

$$C + OH$$

【0092】(A) 成分である酸分解性樹脂は、上記の繰り返し構造単位以外に、ドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにレジストの一般的な必要な特性である解像力、耐熱性、感度等を調節する目的で様々な繰り返し構造単位を含有することができる。

【0093】とのような繰り返し構造単位としては、下 50 記の単量体に相当する繰り返し構造単位を挙げることが できるが、これらに限定されるものではない。これによ り、酸分解性樹脂に要求される性能、特に、(1)塗布 溶剤に対する溶解性、(2)製膜性(ガラス転移点)、

45

(3)アルカリ現像性、(4)膜べり(親疎水性、アル カリ可溶性基選択)、(5)未露光部の基板への密着 性、(6)ドライエッチング耐性、等の微調整が可能と なる。このような単量体として、例えばアクリル酸エス テル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、 メタクリルアミド類、アリル化合物、ピニルエーテル 類、ビニルエステル類等から選ばれる付加重合性不飽和 10 結合を1個有する化合物等を挙げることができる。

【0094】具体的には、以下の単量体を挙げることが できる。

アクリル酸エステル類 (好ましくはアルキル基の炭素数 が1~10のアルキルアクリレート):アクリル酸メチ ル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル 酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸エチ ルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸-t-オ クチル、クロルエチルアクリレート、2-ヒドロキシエ チルアクリレート2、2-ジメチルヒドロキシプロピル 20 アクリレート、5ーヒドロキシペンチルアクリレート、 トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペンタエリ スリトールモノアクリレート、ベンジルアクリレート、 メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアクリレー ト、テトラヒドロフルフリルアクリレート等。

【0095】メタクリル酸エステル類(好ましくはアル キル基の炭素数が1~10のアルキルメタアクリレー ト):メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、 プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレー ト、アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、 シクロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレー ト、クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリ レート、2ーヒドロキシエチルメタクリレート、4ーヒ ドロキシブチルメタクリレート、5-ヒドロキシペンチ ルメタクリレート、2,2-ジメチル-3-ヒドロキシ プロビルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノ メタクリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレ ート、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフ リルメタクリレート等。

【0096】アクリルアミド類:アクリルアミド、N-40 トリル、マレイロニトリル等。 アルキルアクリルアミド (アルキル基としては炭素数1 ~10のもの、例えばメチル基、エチル基、プロピル 基、ブチル基、t-ブチル基、ヘブチル基、オクチル 基、シクロヘキシル基、ヒドロキシエチル基等があ る。)、N, N-ジアルキルアクリルアミド(アルキル 基としては炭素数1~10のもの、例えばメチル基、エ チル基、ブチル基、イソブチル基、エチルヘキシル基、 シクロヘキシル基等がある)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルアクリルアミド、N-2-アセトアミドエチ ルーN-アセチルアクリルアミド等。

[0097] メタクリルアミド類: メタクリルアミド、 N-アルキルメタクリルアミド (アルキル基としては炭 素数1~10のもの、例えばメチル基、エチル基、t-ブチル基、エチルヘキシル基、ヒドロキシエチル基、シ クロヘキシル基等がある)、N、N-ジアルキルメタク リルアミド (アルキル基としてはエチル基、プロビル 基、ブチル基等がある)。NーヒドロキシエチルーNー メチルメタクリルアミド等。

46

【0098】アリル化合物:アリルエステル類(例えば 酢酸アリル、カプロン酸アリル、カブリル酸アリル、ラー ウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸ア リル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリル 等)、アリルオキシエタノール等。

【0099】ビニルエーテル類:アルキルビニルエーテ ル(例えばヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエ ーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニル エーテル、メトキシエチルビニルエーテル、エトキシエ **チルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル、1** -メチル-2, 2-ジメチルプロピルビニルエーテル、 2-エチルブチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビ ニルエーテル、ジエチレングリコールビニルエーテル、 ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエチルアミノ エチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエー テル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒドロフルフリ ルビニルエーテル等。

【0100】ビニルエステル類:ビニルブチレート、ビ ニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビ ニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニルカブ ロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジクロルア 30 セテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブトキシ アセテート、ビニルアセトアセテート、ビニルラクテー ト、ビニルーβーフェニルブチレート、ビニルシクロへ キシルカルボキシレート等。

【0101】イタコン酸ジアルキル類:イタコン酸ジメ チル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチル等。フ マール酸のジアルキルエステル類又はモノアルキルエス テル類;ジブチルフマレート等。

【0102】その他クロトン酸、イタコン酸、無水マレ イン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリロニ

【0103】その他にも、上記種々の繰り返し構造単位 に相当する単量体と共重合可能である付加重合性の不飽 和化合物であれば、共重合されていてもよい。

【0104】酸分解性樹脂において、各繰り返し構造単 位の含有モル比はレジストのドライエッチング耐性や標 準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さ らにはレジストの一般的な必要性能である解像力、耐熱 性、感度等を調節するために適宜設定される。

【0105】酸分解性樹脂中、一般式(1a)で表され 50 る繰り返し単位と一般式(Ib)で表される繰り返し単

位の総量は、全繰り返し構造単位中30~70モル%が 好ましく、より好ましくは35~65モル%、更に好ま しくは40~60モル%である。一般式(Ia)で表さ れる繰り返し単位:一般式(1b)で表される繰り返し 単位(モル比)の範囲は、一般的には99/1~1/9 9、好ましくは90/10~10/90、更に好ましく は80/20~20/80である。酸分解性樹脂中、一 般式 (p III) ~ (p V)で表される脂環式炭化水素を含 む部分構造を有する繰り返し単位の含有量は、全繰り返 し構造単位中30~70モル%が好ましく、より好まし くは35~65モル%、更に好ましくは40~60モル %である。一般式 (I V) ~ (V II) の繰返し単位の含 有量は、総量として、全繰り返し構造単位中5~70モ ル%が好ましく、より好ましくは10~65モル%、更 に好ましくは15~60モル%である。—般式 (Ia) 又は(Ib)で表される繰り返し単位、(p III)~(p V)で表される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する 繰り返し単位等を含む酸分解性基を有する繰返し単位の 含有量は、全繰り返し構造単位中30~70モル%が好 ましく、より好ましくは35~65モル%、更に好まし くは40~60モル%である。

【0106】本発明に用いる酸分解性樹脂は、常法に従 って(例えばラジカル重合)合成することができる。例 えば、一般的合成方法としては、モノマー種を、一括で あるいは反応途中で反応容器に仕込み、とれを必要に応 じ反応溶媒、例えばテトラヒドロフラン、1.4-ジオ キサン、ジイソプロビルエーテルなどのエーテル類やメ チルエチルケトン、メチルイソブチルケトンのようなケ トン類、酢酸エチルのようなエステル溶媒、さらには後 述のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテー トのような本発明の組成物を溶解する溶媒に溶解させ均 一とした後、窒素やアルゴンなど不活性ガス雰囲気下で 必要に応じ加熱、市販のラジカル開始剤(アゾ系開始 剤、パーオキサイドなど)を用いて重合を開始させる。 所望により開始剤を追加、あるいは分割で添加し、反応 終了後、溶剤に投入して粉体あるいは固形回収等の方法 で所望のポリマーを回収する。反応の濃度は20重量% 以上であり、好ましくは30重量%以上、さらに好まし くは40重量%以上である。反応温度は10℃~150 °Cであり、好ましくは30°C~120°C、さらに好まし 40 くは50~100℃である。

【0107】本発明に係る樹脂の重量平均分子量は、GPC法によりポリスチレン換算値として、好ましくは1,000~200,000である。重量平均分子量が1,000未満では耐熱性やドライエッチング耐性の劣化が見られるため余り好ましくなく、200,000を越えると現像性が劣化したり、粘度が極めて高くなるた

め製膜性が劣化するなど余り好ましくない結果を生じる。本発明の組成物がArF露光用であるとき、ArF 光への透明性の点から樹脂は芳香環を有しないことが好ましい。また、樹脂の主鎖に脂環基を有しないことが、コンタクトホールの抜け性に優れる点、またデフォーカスラチチュード(焦点ずれの許容範囲)が顕著に向上する点から好ましい。

【0108】本発明の遠紫外線露光用ポジ型フォトレジスト組成物において、本発明に係わる全ての樹脂の組成物全体中の配合量は、全レジスト固形分中40~99.99重量%が好ましく、より好ましくは50~99.97重量%である。

【0109】(2)(B)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物(光酸発生剤)

本発明で使用する光酸発生剤としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光(400~200nmの紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー光、電子線、X線、分子線又はイオンビームにより酸を発生する化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

【0110】たとえば、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等のオニウム塩、有機ハロゲン化合物、有機金属/有機ハロゲン化物、0-ニトロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、イミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物、ジスルホン化合物、ジアゾケトスルホン、ジアゾジスルホン化合物等を挙げることができる。また、これらの光により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化合物を用いることができる。

【0111】さらにV.N.R.Pillai,Synthesis,(1),1(1980)、A.Abad etal,Tetrahedron Lett.,(47)4555(1971)、D.H.R.Barton etal,J.Chem.Soc.,(C),329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

- 【0112】上記活性光線又は放射線の照射により分解 して酸を発生する化合物の中で、特に有効に併用される 他の光酸発生剤について以下に説明する。
 - (1)トリハロメチル基が置換した下記一般式(PAG
 - 1)で表されるオキサゾール誘導体又は一般式 (PAG
 - 2)で表されるS-トリアジン誘導体。

[0113]

【化40】

【0114】式中、R''は置換もしくは未置換のアリ ール基、アルケニル基、R²⁰²は置換もしくは未置換の アリール基、アルケニル基、アルキル基、-C(Y):

49

* は以下の化合物を挙げることができるがこれらに限定さ れるものではない。

[0115]

[化41] をしめす。Yは塩素原子又は臭素原子を示す。具体的に *10

【0116】(2)下記の一般式 (PAG3)で表され 50 るヨードニウム塩、又は一般式 (PAG4)で表される

.

52

スルホニウム塩。 [0117]

* [化42]

(PAG3)

$$\begin{array}{ccc}
 & R^{203} \\
 & R^{204} & S^{\oplus} & Z^{\ominus} \\
 & & R^{205} & \\
 & & (PA64)
\end{array}$$

【0118】CCで式Ar1、Ar1は、各々独立に、置 換もしくは未置換のアリール基を示す。R201、R201、 R²⁰⁵は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル 基、アリール基を示す。

51

【0119】Z-は、対アニオンを示し、例えばB F_4^- , AsF_6^- , PF_6^- , SbF_6^- , SiF_6^{2-} , C1O, CF, SO, 等のパーフルオロアルカンスルホン 酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオ ン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核 芳香族スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸

アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることがで 10 きるがこれらに限定されるものではない。

【0120】またR²⁰³、R²⁰⁴、R²⁰⁵のうちの2つ及 びAr'、Ar'はそれぞれの単結合又は置換基を介して 結合してもよい。

【0121】具体例としては以下に示す化合物が挙げら れるが、これらに限定されるものではない。

[0122]

[化43]

[化44]

[0123]

[0124] 【化45]

20

特開2002-372784 58

$$\begin{array}{c|c}
& \oplus \\
& & \oplus \\
& & & \oplus \\
\hline
\text{(PAG3-25)}
\end{array}$$

[0126]

[化47]

(PAG4-25)

[化48]

[0127]

[0128]

【化49】

[0129] 【化50】

$$C_{4}F_{9}SO_{3}$$
(PAG4-53)

$$C_4F_9SO_3$$
 (PAG4-56)

 $MeO - O - S - Ph_{2} = O_{3}S - CF_{3} \quad (PAG4-38)$ $MeO - O - S - Ph_{2} = O_{3}S - C_{4}F_{9} \quad (PAG4-39)$ $- O - S - Ph_{2} = O_{3}S - CF_{3} \quad (PAG4-40)$ $- O - S - Ph_{2} = O_{3}S - C_{4}F_{9} \quad (PAG4-41)$ $- O - S - Ph_{2} = O_{3}S - O - CH_{3} \quad (PAG4-42)$ $- O - S - Ph_{2} = O_{3}S - O - CH_{3} \quad (PAG4-43)$

[0130]

[0131] [化52] 【0132】上記において、Phはフェニル基を表す。 一般式 (PAG3)、 (PAG4)で示される上記オニ 20 ウム塩は公知であり、例えば、米国特許第2,807,648号 及び同4,247,473号、特開昭53-101,331号等に記載の方 法により合成することができる。

【0133】(3)下記一般式(PAG5)で表される ジスルホン誘導体又は一般式(PAG6)で表されるイ ミノスルホネート誘導体。

[0134] [化53]

$$Ar^3-SO_2-SO_2-Ar^4$$
 $R^{206}-SO_2-O-N$ (PAG5)

【0135】式中、Ar'は、各々独立に、置換もしくは未置換のアリール基を示す。R'06は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。

【0136】具体例としては以下に示す化合物が挙げら 40 れるが、これらに限定されるものではない。

【0137】 【化54】

[0138]

[化55]

【化56】

[013'9]

40

[0140] [157]

[0141]

[{
$$1 \pm 5 \ 8$$
}]

\[
\begin{align*}

【0142】(4)下記一般式(PAG7)で表されるジアゾジスルホン誘導体。

50 [0143]

【0144】 ここでRは、直鎖、分岐又は環状アルキル基、あるいは置換していてもよいアリール基を表す。 具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0145]

[0146] [(161]

CI
$$\stackrel{N_2}{\longrightarrow} \stackrel{N_2}{\longrightarrow} \stackrel$$

【0147】光酸発生剤の添加量は、組成物中の固形分を基準として、通常0.001~30重量%の範囲で用いられ、好ましくは0.3~20重量%、更に好ましくは0.5~10重量%の範囲で使用される。光酸発生剤

の添加量が、0.001重量%より少ないと感度が低くなり、また添加量が30重量%より多いとレジストの光吸収が高くなりすぎ、プロファイルの悪化や、プロセス(特にベーク)マージンが狭くなり好ましくない。

〔3〕その他の添加剤

本発明のポジ型レジスト組成物には、必要に応じて更に 酸分解性溶解阻止化合物、染料、可塑剤、界面活性剤、 光増感剤、有機塩基性化合物、及び現像液に対する溶解 性を促進させる化合物等を含有させることができる。

【0148】本発明のポジ型レジスト組成物には、好ま しくは(C)フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤 を含有する。本発明のポジ型レジスト組成物には、フッ 素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤及びフッ素原子 と珪素原子の両方を含有する界面活性剤のいずれか、あ るいは2種以上を含有することが好ましい。本発明のポ ジ型レジスト組成物が上記酸分解性樹脂と上記界面活性 剤とを含有することにより、パターンの線幅が一層細い 時に特に有効であり、現像欠陥が一層改良される。とれ らの界面活性剤として、例えば特開昭62-36663号、特開 20 昭61-226746号、特開昭61-226745号、特開昭62-170950 号、特開昭63-34540号、特開平7-230165号、特開平8-62 834号、特開平9-54432号、特開平9-5988号、米国特許54 05720号、同5360692号、同5529881号、同5296330号、同 5436098号、同5576143号、同5294511号、同5824451号記 載の界面活性剤を挙げるととができ、下記市販の界面活 性剤をそのまま用いることもできる。使用できる市販の 界面活性剤として、例えばエフトップEF301、EF303、 (新秋田化成(株)製)、フロラードFC430、431(住友スリ ーエム(株)製)、メガファックF171、F173、F176、F18 30 9、R08 (大日本インキ(株)製)、サーフロンS-382、 SC101、102、103、104、105、106(旭硝子(株)製)、 トロイゾルS-366 (トロイケミカル (株) 製) 等フッ素 系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤を挙げることが できる。またポリシロキサンポリマーKP-341 (信越化 学工業(株)製)もシリコン系界面活性剤として用いる ととができる。

【0149】界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分を基準として、通常0.001重量%~2重量%、好ましくは0.01重量%~1重量%である。これ 5の界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。

【0150】上記の他に使用することのできる界面活性 剤としては、具体的には、ポリオキシエチレンラウリル エーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポ リオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレン オレイルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエー テル類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル等の ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオ キシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックコポリマ (

一類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノバルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリステアレート等のソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソルビタントリステアレート等のポリオキシエチレンソルビタントリステアレート等のポリオキシエチレンソルビタントリステアレート等のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等のノニオン系界面活性剤等を挙げることができる。これらの他の界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分100重量部当たり、通常、2重量部以下、好ましくは1重量部以下である。【0151】本発明で用いることのできる好ましい

(D) 有機塩基性化合物は、フェノールよりも塩基性の 強い化合物である。中でも含窒素塩基性化合物が好まし い。

【0153】 ことで、R'''、R'''及びR'''は、各々独立に、水素原子、炭素数1~6のアルキル基、炭素数1~6のヒドロキシアルキル基又は炭素数6~20の置換もしくは非置換のアリール基であり、ことでR'''とR'''は互いに結合して環を形成してもよい。

··· (A)

[0154]
[{£63}]

-N-C=N- ... (B)

=C-N=C- ... (C)

=C-N- ... (D)

$$R^{253}$$
-C-N-C- R^{256} ... (B)

【0155】(式中、R²³³、R²³⁴、R²³⁴及びR
³³⁶は、各々独立に、炭素数1~6のアルキル基を示す)更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基を有する化合物である。好ましい具体例としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノビリジン、置換もしくは未置換のアミノビリジン、置換もしくは未置換のアミノビリジン、置換もしくは未置換のアミノビリジン、置換もしくは未置換のアミノビリジン、置換もしくは未置換のアミノビリジン、置換もしくは未置換のアミノビリジン、置換もしくは未置換のアミノビリジン、置換もしくは未置換のアミ

ノアルキルピリジン、置換もしくは未置換のアミノピロリジン、置換もしくは未置換のインダーゾル、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン、でが挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル基、アルキル基、アルキル基、アルキル基、アルコキシ基、アシルエ、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリールオキシ基、ニトロ基、水酸基、シアノ基である。

【0156】含窒素塩基性化合物の好ましい具体例とし て、グアニジン、1, 1-ジメチルグアニジン、1, 1, 3, 3, ーテトラメチルグアニジン、2ーアミノビ リジン、3-アミノビリジン、4-アミノビリジン、2 ージメチルアミノビリジン、4 ージメチルアミノビリジ ン、2-ジエチルアミノビリジン、2-(アミノメチ 20 ル) ピリジン、2-アミノ-3-メチルピリジン、2-アミノー4ーメチルピリジン、2-アミノー5-メチル ピリジン、2-アミノ-6-メチルピリジン、3-アミ ノエチルピリジン、4-アミノエチルピリジン、3-ア ミノピロリジン、ピペラジン、N-(2-アミノエチ ル) ピペラジン、N-(2-アミノエチル) ピペリジ ン、4-アミノ-2,2,6,6-テトラメチルピペリ ジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イミノピペリジ ン、1-(2-アミノエチル) ピロリジン、ピラゾー ル、3-アミノ-5-メチルピラゾール、5-アミノ-30 3-メチル-1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2 - (アミノメチル) - 5 - メチルピラジン、ピリミジ ン、2、4ージアミノビリミジン、4、6ージヒドロキ シビリミジン、2-ビラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル) モルフ ォリン、1,5-ジアザビシクロ〔4.3.0〕 ノナー 5-エン、1、8-ジアザビシクロ〔5、4、0〕ウン デカー7ーエン、1,4~ジアザビシクロ〔2.2.2〕 オクタン、2, 4, 5-トリフェニルイミダゾール、N ーメチルモルホリン、N-エチルモルホリン、N-ヒド 40 ロキシエチルモルホリン、N-ベンジルモルホリン、シ クロヘキシルモルホリノエチルチオウレア (CHMET U) 等の3級モルホリン誘導体、特開平11-5257 5号公報に記載のヒンダードアミン類 (例えば該公報 〔0005〕に記載のもの)等が挙げられるがこれに限 定されるものではない。

【0157】特に好ましい具体例は、1,5-ジアザビ、シクロ〔4.3.0〕ノナー5-エン、1,8-ジアザビシクロ〔5.4.0〕ウンデカー7-エン、1,4-ジアザビシクロ〔2.2.2〕オクタン、4-ジメチルアミノビリジン、ヘキサメチレンテトラミン、4,4-ジメチ

ルイミダゾリン、ピロール類、ピラゾール類、イミダゾール類、ピリダジン類、ピリミジン類、CHMETU等の3級モルホリン類、ピス(1、2、2、6、6ーベンタメチルー4ーピペリジル)セバゲート等のヒンダードアミン類等を挙げることができる。中でも、1、5ージアザビシクロ〔4、3、0〕ノナー5ーエン、1、8ージアザビシクロ〔5、4、0〕ウンデカー7ーエン、1、4ージアザピシクロ〔2、2、2〕オクタン、4ージメチルアミノビリジン、ヘキサメチレンテトラミン、CHMETU、ピス(1、2、2、6、6ーベンタメチ 10

77

ルー4ーピペリジル)セバゲートが好ましい。 【0158】これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上組み合わせて用いられる。含窒素塩基性化合物の使用量は、感光性樹脂組成物の全組成物の固形分に対し、通常、0.001~10重量%、好ましくは0.01~5重量%である。0.001重量%未満では上記含窒素塩基性化合物の添加の効果が得られない。一方、10重量%を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

【0159】本発明のポジ型レジスト組成物は、上記各 成分を溶解する溶剤に溶かして支持体上に塗布する。と こで使用する溶剤としては、エチレンジクロライド、シ クロヘキサノン、シクロペンタノン、2-ヘプタノン、 **γ**-ブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレング リコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノ エチルエーテル、2 - メトキシエチルアセテート、エチ レングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロビ レングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコ ールモノメチルエーテルアセテート、トルエン、酢酸エ チル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸 30 メチル、エトキシプロビオン酸エチル、ピルビン酸メチ ル、ビルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、N,N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メ チルビロリドン、テトラヒドロフラン等が好ましく、と れらの溶剤を単独あるいは混合して使用する。

【0160】上記の中でも、好ましい溶剤としてはプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、2ーヘブタノン、アーブチロラクトン、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、アロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、Nーメチルピロリドン、テトラヒドロフランを挙げることができる。

【0161】本発明のとのようなポジ型レジスト組成物は基板上に塗布され、薄膜を形成する。この塗膜の膜厚は0.2~1.2μmが好ましい。本発明において使用することができる無機基板とは、通常のBareSi基板、SOC基板、あるいは次に記載の無機の反射防止膜を有する

基板等を挙げることができる。また、本発明において は、必要により、市販の無機あるいは有機反射防止膜を 使用することができる。

【0162】反射防止膜としては、チタン、二酸化チタ ン、窒化チタン、酸化クロム、カーボン、αーシリコン 等の無機膜型と、吸光剤とポリマー材料からなる有機膜 型が用いることができる。前者は膜形成に真空蒸着装 置、CVD装置、スパッタリング装置等の設備を必要と する。有機反射防止膜としては、例えば特公平7-69 611号記載のジフェニルアミン誘導体とホルムアルデ ヒド変性メラミン樹脂との縮合体、アルカリ可溶性樹 脂、吸光剤からなるものや、米国特許5294680号 記載の無水マレイン酸共重合体とジアミン型吸光剤の反 応物、特開平6-118631号記載の樹脂バインダー とメチロールメラミン系熱架橋剤を含有するもの、特開 平6-118656号記載のカルボン酸基とエポキシ基 と吸光基を同一分子内に有するアクリル樹脂型反射防止 膜、特開平8-87115号記載のメチロールメラミン とベンゾフェノン系吸光剤からなるもの、特開平8-1 79509号記載のポリピニルアルコール樹脂に低分子 吸光剤を添加したもの等が挙げられる。また、有機反射 防止膜として、ブリューワーサイエンス社製のDUV3 0シリーズや、DUV-40シリーズ、ARC25、シ プレー社製のAC-2、AC-3、AR19、AR20 等を使用することもできる。

【0163】上記レジスト液を精密集積回路素子の製造に使用されるような基板(例:シリコン/二酸化シリコン被覆)上に(必要により上記反射防止膜を設けられた基板上に)、スピナー、コーター等の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光し、ベークを行い現像することにより良好なレジストパターンを得ることができる。ここで露光光としては、好ましくは150 nm~250nmの波長の光である。具体的には、KrFエキシマレーザー(248nm)、ArFエキシマレーザー(193nm)、F,エキシマレーザー(157nm)、X線、電子ビーム等が挙げられる。

【0164】現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、ロープロピルアミン等の第一アミン類、シエチルアミン、ジーローブチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキンド等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピヘリジン等の環状アミン類等のアルカリ性水溶液を使用することができる。更に、上記アルカリ性水溶液にアルコール類、界面活性剤を適当量添加して使用することもでき

50 る。

[0165]

【実施例】以下、本発明を実施例によって更に具体的に 説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもので はない。

【0166】樹脂(1)の合成

2-エチル-2-アダマンチルメタクリレート、イソア ダマンチルメタクリレート、ブチロラクトンメタクリレ ート、メタクリル酸を25/25/40/10の割合で 仕込みメチルイソブチルケトンに溶解し、固形分濃度3 0%の溶液100mLを調製した。この溶液に和光純薬 10 順番を示す) 製V-601を4mol%加え、これを窒素雰囲気下、 4時間かけて80℃に加熱したメチルイソブチルケトン 10mLに滴下した。滴下終了後、反応液を4時間加熱*

*攪拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、蒸留 水/ ISOプロピルアルコール=1/1の混合溶媒1L に晶析、析出した白色粉体をメタノール1Lで洗浄し、 目的物である樹脂(1)を回収した。C13 NMRから求 めたポリマー組成比は22/27/39/12であっ た。また、GPC測定により求めた標準ポリスチレン換 算の重量平均分子量は8700であった。上記合成例と 同様の操作で下表に示す組成比、分子量の樹脂を合成し た。(繰り返し単位1、2、3、4は構造式の左からの

[0167] 【表1】

樹脂	繰り返し単位 1	繰り返し単位 2	繰り返し単位3	繰り返し単位4	分子量
	一般式 Ia	一般式 1b	(mol%)	(mol%)	
	(mai%)	(mol%)			
2	26	25	38	13	9100
3	25	24	36	15	8900
4.	28	26	34	12	9000
5	: 24	28	22	28	8100
6	29	20	26	25	7100
7	28	20	25	27	9400
8	30	21	47	2	10200
9	28	23	18	33	7800
10	26	28	34	12	9200
11	20	33	30	17	8600
12	30	25	42	3	10200
13	28	28	35	10	9300
14	35	25	20	20	8500
15	26 ·	25	35	. 44 .	8200
18	20	18	41	21	9700
17	15	18	40	27	10100
18	17	19	44	20	8400

【0168】また、以下に上記樹脂(1)~(18)の 構造を示す。

[0169] 【化64】

特開2002-372784 82

[化65]

[0170]

[0171]

[作66]

[化67]

[0172]

(

$$-CH_{2}-C - CH_{2}-C - CH_{3}-C - CH_{3}-C$$

$$-CH_{2}-\overset{C}{C}--CH_{2}-\overset{C}{C}--CH_{2}-\overset{C}{C}--CH_{2}-\overset{C}{C}-$$

$$\overset{C}{C}=\overset{C}{C}-\overset$$

[0173]

[化68]

$$-CH_{2}-\overset{H}{C}-CH_{2}-\overset{H}{C}-CH_{2}-\overset{C}{C}-CH_{2}-\overset{C}{C}-CH_{2}-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}$$

【0174】実施例1~18及び比較例1

(ポジ型レジスト組成物組成物の調製と評価)上記合成例で合成した表2に示す各成分を配合し、それぞれ固形分14重量%の割合でプロビレングリコールモノメチルエーテルアセテートに溶解した後、0.1μmのミクロ 30

フィルターで濾過し、実施例1~18と比較例1のポジ型レジスト組成物を調製した。

[0175]

【表2】

表2				
	樹脂	光融発生剤	塩基性	界面
	(1, 5g)		化合物.	活性剤
	·		(4mg)	(10mg)
実施例1	(1)	PAG4-6=32mg	なし	W4
2	(2)	PAG4-36=30mg	1	なし
3	(3)	PAG4-38/4-39=5/29mg	2 .	W5
4	(4)	PAG4-48/4-58=28/10mg	4	W5
5	(5)	PAG4-52/4-54-20/20mg	6	W3
6	(6)	PAG4-45=32mg	6	W2
7	(7)	PAG4-34/4-53=10/30mg	3	Wi
8	(8)	PAG3-21/4-50=10/20mg	4	W5
9	(9)	PAG4-48/4-55=26/20mg	5	W5
10	(10)	PAG4-39/6-27=30/5mg	6	W5
.11	(11)	PAG4-5/4-53=5/35mg	4	wз
12	(12)	PAG4-36/4-56=10/40mg	3	W2
13	(13)	PAG4-50/4-55=20/30mg	1	W1
14	(14)	PAG4-49/4-53=5/40mg	2	W2
15	(15)	PAG4-53/7-5=30/10mg	3	WЗ
16	(16)	PAG4~48=40mg	5	. W5
17	(17)	PAG4-48=40mg	5	Wő
18	(18)	PAG4-48=40mg	5	W5
比較例1	(R)	PAG4~5=30mg	なし	なし

【0176】界面活性剤としては、

₩1:メガファックF176 (大日本インキ (株) 製) (フッ素系)

W2: メガファックR08 (大日本インキ (株) 製) (フッ素及びシリコーン系)

₩3:ポリシロキサンポリマーKP-341 (信越化学 工業(株)製)

₩4:ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル ₩5:トロイゾルS-366(トロイケミカル(株)

製)

を表す。

【0177】アミンとしては、

1は、1、5-ジアザビシクロ〔4.3.0〕-5-ノ ネン(DBN)を表し、

2は、ビス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルー4-ピペリジル) セバゲート

3は、トリnーブチルアミン

4は、トリフェニルイミダゾール

5は、アンチピリン

6は、2、6-ジイソプロビルアニリン を表す。

比較樹脂R:特開平11-119434号の実施例に準 じて合成した2-メチル-2-アダマンチルメタクリレ ート/メバロニックラクトンメタクリレート/tープチ ルメタクリレート(モル比50/30/20)

[0178]初めに Brewer Science社 製AR-19をスピンコーターを利用してシリコンウェ

ポジ型フォトレジスト組成物を塗布し、140℃で90 秒間乾燥、約0.4μmのポジ型フォトレジスト膜を作 成し、それにA r F エキシマレーザー (波長193n m、NA=0.6のISI社製ArFステッパー)で1 /2 ピッチのコンタクトホールバターン (マスクサイズ 0.15ミクロン) により露光量を変化させながら露光 した。露光後の加熱処理を120℃で90秒間行い、

30 2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシ ド水溶液で現像、蒸留水でリンスし、レジストパターン プロファイルを得た。このようにして得られたシリコン ウエハーのレジストバターンを走査型顕微鏡で観察し、 レジストを下記のように評価した。

【0179】〔感度〕: 直径0.15 µmのコンタク トホールを再現する最小露光量を感度とし、実施例1の レジスト露光量を1.0としたときの相対露光量を相対 感度(他のレジストの露光量/実施例1の露光量)とし て表現した。

40 【0180】〔疎密依存性〕: 0.15 μ m のコンタ クトホール (密パターン ピッチ1/2) と孤立コンタ クトホールパターン (疎パターン ピッチ1/10) に おいて、それぞれ0. 15 µm±10%を許容する焦点 深度の重なり範囲を求めた。この範囲が大きいほどが良 好なことを示す。

〔エッチング時表面荒れ〕: 0.15μmのコンタク トホールパターンをCHF;/O,=8/2プラズマで6 0秒間エッチングを行い、得られたサンプルの断面、及 び表面をSEMで観察し、ピンホール状の欠陥(非加工 ハー上に85nm塗布、乾燥した後、その上に得られた 50 予定部位の下層がエッチングされてしまう)を生じるも

のを×、表面荒れは生じたが欠陥は生じず、但し、ホールの変形があるものを△、表面荒れが小さく、ホールの変形のない良好なものを○とした。

[0181]

【表3】

表3				
	感度	辞密依存性	エッチング時	
		(µm)	の表面荒れ	
实施例1	1 0.4		0	
2	1. 1	0. 45	0	
3	0. 95	O. 55	0	
4	0. 9	0. 6	.0	
5	1. 15	0. 5	0	
6	1, 15	0. 5	0	
7	1. 15	0. 5	0	
8	1. 1	0. 55	0	
9	1. 05	0. 56	0	
10	0. 9	0. 6	0	
11	0. 8	0. 6	0	
12	0. 95	0. 55	0	
13	0. 85	0. 6	0	
14	0. 9	0. 6	0	
15	1.0	0. 55	0	
16	1. 25	0. 6	0	
17	1. 25	0.6	0	
18	1. 2	0. 6	0	
比較例1	1. 85	0. 1	×	

*【0182】表3の結果から明らかなように、本発明の ボジ型レジスト組成物は、高感度であり、疎密依存性及 びエッチング時の表面荒れが小さく、優れていることが 判る。

[0183]

【発明の効果】本発明は、高感度であり、疎密依存性及びエッチング時の表面荒れが小さいポジ型レジスト組成物を提供することができる。この本発明のポジ型レジスト組成物は、遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使用するミクロファブリケーションに好適に使用できる。

20

*

フロントページの続き

F ターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AB16 AC08 AD03 BE00 BE10 BG00 CB14 CB41 CC04 CC20 FA10

> 4J100 AL08P AL08Q BA15P BC02P BC04P BC04Q BC08P BC09P BC09Q BC12P CA04 CA05 JA38